



Soitec 宣布其应用在三维图像传感设备上的衬底获得突破

新的成像器-SOI 衬底使硅基图像传感器能够 提高近红外光谱性能

贝宁（格勒诺布尔），法国，2017 年 11 月 30 日-电子行业和制造半导体材料设计的领导者 Soitec 今天宣布用于其专门为制造在近红外（NIR）应用中（包括先进的三维图像传感器）正面成像而设计的成像-SOI 产品线上的最新一代绝缘层上硅（SOI）衬底。Soitec 现在可以大量提供高成熟度的新 SOI 晶圆，以满足增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、面部识别安全系统，先进的人机接口以及其他新兴应用中不断增长的 3D 相机市场需求。

“我们最新的成像仪-SOI 衬底代表公司取得的一个主要成就，以及一个可增加在近红外光谱领域性能的非常聪明的方法，加快了不断增长的 3D 成像和传感市场上新的应用，” Soitec 数码电子事业部执行副总裁 Christophe Maleville 说道。“在 SOI 的衬底上构建这些创新传感器设计代表是通过利用我们在超薄层传输方面的先进技术和我们在制造埋氧化层（盒）层衬底上的广泛的制造经验”实现的。

新的 SOI 衬底使得能够将高分辨率硅基 CMOS 图像传感器的工作范围轻松扩展到近红外光谱中。这种优化的 SOI 衬底大大提高了近红外光谱的信噪比。

根据 Yole Développement 的报告，三维成像和传感设备市场预计在未来五年的复合增长率将达到 37.7%，2022 的销售额达到 90 亿美元。市场研究和咨询公司预测，2018 可能会看到大量的产品涌入，而首先的应用会是在移动电子和计算领域。

*来源：三维成像和传感报告，Yole Développement，2017 年 4 月。

关于 Soitec : Soitec (技术 40 巴黎, 泛欧交易所,) 是一个世界范围内设计和制造创新半导体材料的领导者。该公司利用其独特的技术和半导体专业知识为电子市场提供服务。拥有超过 3000 个全球专利, SOITEC 的战略是基于颠覆性创新来满足客户对于高性能、能源效率和成本竞争力的需求。Soitec 的生产设施、研发中心和办事处位于欧洲、美国和亚洲。更多信息, 请访问 www.soitec.com 和关注我们的 Twitter : @ Soitec_EN

Soitec 和 Smart Cut 是 Soitec 的注册商标。

媒体请联系 :

Camille Dufour

+33 (0)6 79 49 51 43

camille.dufour@soitec.com

###